2017-2022年中国芯片行业深度调研及市场前景预测报告

报告大纲

智研咨询
www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2017-2022年中国芯片行业深度调研及市场前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chyxx.com/research/201611/470591.html

报告价格：电子版: 9800元　纸介版：9800元　电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

中国是全球最大的存储器芯片市场，2015年采购DRAM（动态随机存储器）估计为120亿美元，NANDFlash（闪存）为66.7亿美元，分别占全球供货量的21.6%和29.1%。

随着智能穿戴、车用电子和机顶盒等需求的增加，对低容量的NANDFlash存储器的需求空间巨大。而国际巨头退出了低容量的行列，对国内存储器行业是一大利好。除了内生发展，中国芯片未来两年可能会参与更多的海内外产业整合。

2014-2015年全球主要IC厂商资本支出情况

以晶圆代工行业为例，2014年全球晶圆代工市场营收总金额达469亿美元，排名前十的代工厂商就占有了90.6%的市场份额，其中台积电以251.8亿美元继续保持首位，虽然国内的中芯国际、华虹宏力都有上榜，但是由于晶圆代工行业具有规模效应，行业龙头台积电几乎吃掉了行业的大部分利润。同样的现象也存在于IC设计行业，在中国大陆目前约600多家的IC设计厂商中，年营收达到或者接近10亿美元的厂商，仅有华为海思、展讯通信两家。

2014全球晶圆代工企业营收排行榜TOP10（百万美元）

智研咨询发布的《2017-2022年中国芯片行业深度调研及市场前景预测报告》共十三章。首先介绍了芯片行业市场发展环境、芯片整体运行态势等，接着分析了芯片行业市场运行的现状，然后介绍了芯片市场竞争格局。随后，报告对芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对芯片产业有个系统的了解或者想投资芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 芯片行业的总体概述
1.1 基本概念
1.2 制作过程
1.2.1 原料晶圆
1.2.2 晶圆涂膜
1.2.3 光刻显影
1.2.4 掺加杂质
1.2.5 晶圆测试
1.2.6 芯片封装

1.2.7 测试包装
第二章 2014-2016年全球芯片产业发展分析
2.1 2014-2016年世界芯片市场综述
2.1.1 市场特点分析
2.1.2 全球发展形势
2.1.3 全球市场规模
2.1.4 市场竞争格局
2.2 美国
2.2.1 全球市场布局
2.2.2 行业并购热潮
2015年全球IC行业重大并购情况

2.2.3 行业从业人数
2.2.4 类脑芯片发展
2.3 日本
2.3.1 产业订单规模
2.3.2 技术研发进展
2.3.3 芯片工厂布局
2.3.4 日本产业模式
2.3.5 产业战略转型
2.4 韩国
2.4.1 产业发展阶段
2.4.2 技术发展历程
2.4.3 外贸市场规模
2.4.4 产业创新模式
2.4.5 市场发展战略
2.5 印度
2.5.1 芯片设计发展形势
2.5.2 政府扶持产业发展
2.5.3 产业发展对策分析
2.5.4 未来发展机遇分析
2.6 其他国家芯片产业发展分析
2.6.1 英国
2.6.2 德国
2.6.3 瑞士

第三章 中国芯片产业发展环境分析
3.1 政策环境
3.1.1 智能制造政策
3.1.2 集成电路政策
3.1.3 半导体产业规划
3.1.4 “互联网+”政策
3.2 经济环境
3.2.1 国民经济运行状况
3.2.2 工业经济增长情况
3.2.3 固定资产投资情况
3.2.4 经济转型升级形势
3.2.5 宏观经济发展趋势
3.3 社会环境
3.3.1 互联网加速发展
3.3.2 智能产品的普及
3.3.3 科技人才队伍壮大
3.4 技术环境
3.4.1 技术研发进展
3.4.2 无线芯片技术
3.4.3 技术发展趋势
第四章 2014-2016年中国芯片产业发展分析
4.1 中国芯片行业发展综述
4.1.1 产业发展历程
4.1.2 全球发展地位
4.1.3 海外投资标的
4.2 2014-2016年中国芯片市场格局分析
4.2.1 市场规模现状
4.2.2 市场竞争格局
4.2.3 行业利润流向
4.2.4 市场发展动态
2015年中国IC行业重大并购情况

4.3 2014-2016年中国量子芯片发展进程
4.3.1 产品发展历程
4.3.2 市场发展形势

4.3.3 产品研发动态
4.3.4 未来发展前景
4.4 2014-2016年芯片产业区域发展动态
4.4.1 湖南
4.4.2 贵州
4.4.3 北京
4.4.4 晋江
4.5 中国芯片产业发展问题分析
4.5.1 产业发展困境
4.5.2 开发速度放缓
4.5.3 市场垄断困境
4.6 中国芯片产业应对策略分析
4.6.1 企业发展战略
4.6.2 突破垄断策略
4.6.3 加强技术研发
第五章 2014-2016年中国芯片产业上游市场发展分析
5.1 2014-2016年中国半导体产业发展分析
5.1.1 行业发展意义
5.1.2 产业政策环境
5.1.3 市场规模现状
5.1.4 产业资金投资
5.1.5 市场前景分析
5.1.6 未来发展方向
5.2 2014-2016年中国芯片设计行业发展分析
5.2.1 产业发展历程
5.2.2 市场发展现状
5.2.3 市场竞争格局
5.2.4 企业专利情况
5.2.5 国内外差距分析
5.3 2014-2016年中国晶圆代工产业发展分析
5.3.1 晶圆加工技术
5.3.2 国外发展模式
5.3.3 国内发展模式
5.3.4 企业竞争现状
5.3.5 市场布局分析

5.3.6 产业面临挑战
第六章 2014-2016年芯片设计行业重点企业经营分析
6.1 高通公司
6.1.1 企业发展概况
6.1.2 经营效益分析
6.1.3 新品研发进展
6.1.4 收购动态分析
6.1.5 未来发展战略
6.2 博通有限公司（原安华高科技）
6.2.1 企业发展概况
6.2.2 经营效益分析
6.2.3 企业收购动态
6.2.4 产品研发进展
6.2.5 未来发展前景
6.3 英伟达
6.3.1 企业发展概况
6.3.2 经营效益分析
6.3.3 产品研发动态
6.3.4 企业战略合作
6.3.5 未来发展战略
6.4 AMD
6.4.1 企业发展概况
6.4.2 经营效益分析
6.4.3 产品研发进展
6.4.4 未来发展前景
6.5 Marvell
6.5.1 企业发展概况
6.5.2 经营效益分析
6.5.3 行业发展地位
6.5.4 布局智能家居
6.5.5 未来发展规划
6.6 赛灵思
6.6.1 企业发展概况
6.6.2 经营效益分析
6.6.3 企业收购动态

6.6.4 产品研发进展
6.6.5 未来发展前景
6.7 Altera
6.7.1 企业发展概况
6.7.2 经营效益分析
6.7.3 产品研发进展
6.7.4 主要应用市场
6.7.5 企业合作动态
6.8 Cirrus logic
6.8.1 企业发展概况
6.8.2 经营效益分析
6.8.3 主要订单规模
6.8.4 未来发展前景
6.9 联发科
6.9.1 企业发展概况
6.9.2 经营效益分析
6.9.3 产品发布动态
6.9.4 产品发展战略
6.9.5 企业投资规划
6.10 展讯
6.10.1 企业发展概况
6.10.2 经营效益分析
6.10.3 新品研发进展
6.10.4 产品应用情况
6.10.5 未来发展前景
6.11 其他企业
6.11.1 海思
6.11.2 瑞星
6.11.3 Dialog
第七章 2014-2016年晶圆代工行业重点企业经营分析
7.1 格罗方德
7.1.1 企业发展概况
7.1.2 经营效益分析
7.1.3 产品研发进程
7.1.4 技术工艺开发

7.1.5 未来发展规划
7.2 三星
7.2.1 企业发展概况
7.2.2 经营效益分析
7.2.3 市场竞争实力
7.2.4 市场发展战略
7.2.5 未来发展前景
7.3 Tower jazz
7.3.1 企业发展概况
7.3.2 经营效益分析
7.3.3 企业合作动态
7.3.4 企业发展战略
7.3.5 未来发展前景
7.4 富士通
7.4.1 企业发展概况
7.4.2 经营效益分析
7.4.3 产品研发动态
7.4.4 未来发展前景
7.5 台积电
7.5.1 企业发展概况
7.5.2 经营效益分析
7.5.3 产品研发进程
7.5.4 工艺技术优势
7.5.5 未来发展规划
7.6 联电
7.6.1 企业发展概况
7.6.2 经营效益分析
7.6.3 产品研发进展
7.6.4 市场布局规划
7.6.5 未来发展前景
7.7 力晶
7.7.1 企业发展概况
7.7.2 经营效益分析
7.7.3 新品研发进展
7.7.4 市场布局规划

7.7.5 未来发展前景
7.8 中芯
7.8.1 企业发展概况
7.8.2 经营效益分析
7.8.3 企业发展规划
7.8.4 企业收购动态
7.8.5 产能利用情况
7.9 华虹
7.9.1 企业发展概况
7.9.2 经营效益分析
7.9.3 企业发展形势
7.9.4 产品发展方向
7.9.5 未来发展前景
第八章 2014-2016年中国芯片产业中游市场发展分析
8.1 2014-2016年中国芯片封装行业发展分析
8.1.1 封装技术介绍
8.1.2 市场发展现状
8.1.3 国内竞争格局
8.1.4 技术发展趋势
8.2 2014-2016年中国芯片测试行业发展分析
8.2.1 IC测试原理
8.2.2 测试准备规划
8.2.3 主要测试分类
8.2.4 发展面临问题
8.3 中国芯片封测行业发展方向分析
8.3.1 承接产业链转移
8.3.2 集中度持续提升
8.3.3 国产化进程加快
8.3.4 产业短板补齐升级
8.3.5 加速淘汰落后产能
第九章 2014-2016年芯片封装测试行业重点企业经营分析
9.1 Amkor
9.1.1 企业发展概况
9.1.2 经营效益分析
9.1.3 企业并购动态

9.1.4 全球市场布局
9.2 日月光
9.2.1 企业发展概况
9.2.2 经营效益分析
9.2.3 企业合作动态
9.2.4 汽车电子封测
9.3 矽品
9.3.1 企业发展概况
9.3.2 经营效益分析
9.3.3 企业合作动态
9.3.4 封测发展规划
9.3.5 未来发展前景
9.4 南茂
9.4.1 企业发展概况
9.4.2 经营效益分析
9.4.3 封测业务情况
9.4.4 资金投资情况
9.4.5 未来发展前景
9.5 颀邦
9.5.1 企业发展概况
9.5.2 经营效益分析
9.5.3 主要业务合作
9.5.4 未来发展前景
9.6 长电科技
9.6.1 企业发展概况
9.6.2 经营效益分析
9.6.3 企业发展现状
9.6.4 业务经营分析
9.6.5 财务状况分析
9.6.6 企业战略分析
9.6.7 未来前景展望
9.7 天水华天
9.7.1 企业发展概况
9.7.2 经营效益分析
9.7.3 业务经营分析

9.7.4 财务状况分析
9.7.5 未来前景展望
9.8 通富微电
9.8.1 企业发展概况
9.8.2 行业地位分析
9.8.3 生产规模分析
9.8.4 经营效益分析
9.8.5 业务经营分析
9.8.6 企业发展动态
9.8.7 财务状况分析
9.8.8 未来前景展望
9.9 士兰微
9.9.1 企业发展概况
9.9.2 经营效益分析
9.9.3 业务经营分析
9.9.4 财务状况分析
9.9.5 未来前景展望
9.10 其他企业
9.10.1 UTAC
9.10.2 J-Device
第十章 2014-2016年中国芯片产业下游应用市场发展分析
10.1 LED
10.1.1 全球市场规模
10.1.2 LED芯片厂商
10.1.3 主要企业布局
10.1.4 封装技术难点
10.1.5 LED产业趋势
10.2 物联网
10.2.1 产业链的地位
10.2.2 市场发展现状
10.2.3 物联网wifi芯片
10.2.4 国产化的困境
10.2.5 产业发展困境
10.3 无人机
10.3.1 全球市场规模

10.3.2 市场竞争格局
10.3.3 主流主控芯片
10.3.4 芯片重点应用领域
10.3.5 市场前景分析
10.4 北斗系统
10.4.1 北斗芯片概述
10.4.2 产业发展形势
10.4.3 芯片生产现状
10.4.4 芯片研发进展
10.4.5 资本助力发展
10.4.6 产业发展前景
10.5 智能穿戴
10.5.1 全球市场规模
10.5.2 行业发展规模
10.5.3 企业投资动向
10.5.4 芯片厂商对比
10.5.5 行业发展态势
10.5.6 商业模式探索
10.6 智能手机
10.6.1 市场发展形势
10.6.2 手机芯片现状
10.6.3 市场竞争格局
10.6.4 产品性能情况
10.6.5 发展趋势分析
10.7 汽车电子
10.7.1 市场发展特点
10.7.2 市场规模现状
10.7.3 出口市场状况
10.7.4 市场结构分析
10.7.5 整体竞争态势
10.7.6 汽车电子渗透率
10.7.7 未来发展前景
10.8 生物医药
10.8.1 基因芯片介绍
10.8.2 主要技术流程

10.8.3 技术应用情况
10.8.4 生物研究的应用
10.8.5 发展问题及前景
第十一章 2014-2016年中国集成电路产业发展分析
11.1 中国集成电路行业总况分析
11.1.1 国内市场崛起
11.1.2 产业政策推动
11.1.3 主要应用市场
11.1.4 产业增长形势
11.2 2014-2016年集成电路市场规模分析
11.2.1 全球市场规模
11.2.2 市场规模现状
11.2.3 市场供需分析
11.2.4 产业链的规模
11.2.5 外贸规模分析
11.3 2014-2016年中国集成电路市场竞争格局
11.3.1 进入壁垒提高
11.3.2 上游垄断加剧
11.3.3 内部竞争激烈
11.4 中国集成电路产业发展的问题及对策
11.4.1 发展面临问题
11.4.2 发展对策分析
11.4.3 产业突破方向
11.4.4 “十三五”发展建议
11.5 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析
11.5.1 全球市场趋势
11.5.2 国内行业趋势
11.5.3 行业机遇分析
11.5.4 市场规模预测
第十二章 中国芯片行业投资分析
12.1 行业投资现状
12.1.1 全球产业并购
12.1.2 国内并购现状
12.1.3 重点投资领域
12.2 产业并购动态

12.2.1 ARM
12.2.2 Intel
12.2.3 NXP
12.2.4 Dialog
12.2.5 Avago
12.2.6 长电科技
12.2.7 紫光股份
12.2.8 Microsemi
12.2.9 Western Digital
12.2.10 ON Semiconductor
12.3 投资风险分析
12.3.1 宏观经济风险
12.3.2 环保相关风险
12.3.3 产业结构性风险
12.4 融资策略分析
12.4.1 项目包装融资
12.4.2 高新技术融资
12.4.3 BOT项目融资
12.4.4 IFC国际融资
12.4.5 专项资金融资
第十三章 中国芯片产业未来前景展望（ZY GXH）
13.1 中国芯片市场发展机遇分析
13.1.1 市场机遇分析
13.1.2 国内市场前景
13.1.3 产业发展趋势
13.2 中国芯片产业细分领域前景展望
13.2.1 芯片材料
13.2.2 芯片设计
13.2.3 芯片制造
13.2.4 芯片封测 （ZY GXH）
附录：
附录一：国家集成电路产业发展推进纲要
图表目录 ：
图表1 1995-2015年全球半导体市场销售规模
图表2 2015-2016年全球芯片销售规模

图表3 2014年全球IC公司市场占有率
图表4 2014年欧洲IC设计公司销售规模
图表5 1986-2015年美国半导体行业从业人员规模变动情况
图表6 1900-2015年人类每秒每$1000成本所得到的计算能力增长曲线
图表7 28nm单个晶体管历史成本
图表8 日本综合电机企业的半导体业务重组
图表9 东芝公司半导体事业改革框架
图表10 智能制造系统架构
图表11 智能制造系统层级
图表12 MES制造执行与反馈流程
图表13 云平台体系架构
图表14 2011-2015年国内生产总值及其增长速度
图表15 2015年年末人口数及其构成
图表16 2011-2015年城镇新增就业人数
图表17 2011-2015年全员劳动生产率
图表18 2015年居民消费价格月度涨跌幅度
图表19 2015年居民消费价格比2014年涨跌幅度
图表20 2015年新建商品住宅月同比价格上涨、持平、下降城市个数变化情况
图表21 2011-2015年全国一般公共预算收入
图表22 2011-2015年年末国家外汇储备
图表23 2011-2015年粮食产量
图表24 2011-2015年社会消费品零售总额
图表25 2011-2015年货物进出口总额
图表26 2015年货物进出口总额及其增长速度
图表27 2015年主要商品出口数量、金额及其增长速度
图表28 2015年主要商品进口数量、金额及其增长速度
图表29 2015年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度
图表30 2015年外商直接投资（不含银行、证券、保险）及其增长速度
图表31 2015年对外直接投资额（不含银行、证券、保险）及其增长速度
图表32 2015年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度
图表33 2015年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度
图表34 2011-2015年快递业务量及增长速度
图表35 2011-2015年年末固定互联网宽带接入用户和移动宽带用户数
图表36 2015年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度
图表37 2014-2015年各月累计主营业务收入与利润总额同比增速

图表38 2014-2015年各月累计利润率与每百元主营业务收入中的成本
图表39 2015年规模以上工业企业主要财务指标
图表40 2015年规模以上工业企业经济效益指标
图表41 2015年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）
图表42 2014-2015年固定资产投资（不含农户）同比增速
图表43 2015-2016年固定资产投资（不含农户）同比增速
图表44 2015-2016年固定资产投资到位资金同比增速
图表45 More Moore&More Than Moore
图表46 台积电晶圆制程技术路线
图表47 英特尔晶圆制程技术路线
图表48 晶圆制造新制程的研发成本
图表49 芯片封装技术发展路径
图表50 芯片封装技术发展趋势
图表51 TSV3DIC封装结构
图表52 IC制造3D封装技术的关键材料挑战
图表53 中国主要集成电路芯片生产线的分布
图表54 2014-2015年全球主要IC厂商资本支出情况
图表55 2014年全球晶圆代工企业营收排行榜Top10
图表56 现用芯片设计工艺的发展趋势
图表57 量子计算的物理实现方案
图表58 量子计算机发展历程
图表59 半导体是自主可控与信息安全的重要支柱
图表60 国家近年来出台的集成电路政策支持文件
图表61 国家支持政策搭建产业环境
图表62 2003-2014年全球半导体市场需求各地区占比
图表63 2015-2017年全球各地区半导体市场规模及增长率
图表64 2015年全球8寸晶圆产能分布
图表65 2015年全球12寸晶圆产能分布
图表66 半导体产业链
图表67 2014年全球十大半导体设备商市场份额
图表68 2011-2015年我国集成电路产业固定资产投资
图表69 2011-2015年我国集成电路创新产品和技术获奖情况
图表70 2014年全球半导体下游应用结构
图表71 2015我国半导体下游应用结构
图表72 2012-2018年平均每辆汽车半导体成本

图表73 2010-2016年中国汽车电子市场规模
图表74 2012-2015年我国云计算市场规模
图表75 2016-2018年我国云计算市场规模预测
图表76 2012-2015年我国可穿戴设备市场规模
图表77 2016-2018年我国可穿戴设备市场规模预测
图表78 2011-2016年日本半导体设备BB值
图表79 2011-2016年北美半导体设备BB值
图表80 2014-2018年全球半导体的资本支出和设备投资规模
图表81 2014-2015年各地区半导体材料市场规模
图表82 2013-2016年全球晶圆制造与封装材料市场规模
图表83 2011-2015年中国半导体制造材料市场规模
图表84 中国半导体制造材料市场规模
图表85 2015年国家集成电路产业投资基金投资结构
图表86 大基金投资半导体全产业链
图表87 2013-2015年中国集成电路产业并购事件
图表88 各地方基金设立和投资情况引导社会资本投入
图表89 半导体全产业链示意图
图表90 1996-2014年半导体全球半导体销售额趋势图
图表91 半导体产品的主要分类
图表92 IC设计的不同阶段
图表93 2015年全球各地区IC设计公司营收占比
图表94 IC产品分类图（依功能划分）
图表95 各部分IC市场份额
图表96 存储芯片的分类
图表97 2016年NAND Flash品牌厂商营收排名
图表98 2016年DRAM品牌厂商营收排名
图表99 2014年前十大模拟IC厂商销售额
图表100 2015年全球芯片设计公司销售top10
图表101 2015年中国十大集成电路设计企业专利授权情况
图表102 2015年全球十大集成电路设计企业中国专利授权情况
图表103 2015年中国十大集成电路制造企业专利授权情况
图表104 2015年全球十大集成电路制造企业专利授权情况
图表105 光刻原理
图表106 掺杂及构建CMOS单元原理
图表107 晶圆加工制程图例

图表108 2013年全年营收前12的晶圆代工企业
图表109 2014-2015年晶圆代工厂商排名
图表110 2013-2016年三大半导体厂资本支出
图表111 2015年主要的半导体厂商
图表112 2015年中国集成电路现有产能分布图
图表113 2014-2015财年高通公司综合收益表
图表114 2014-2015财年高通公司收入分地区资料
图表115 2015-2016财年高通公司综合收益表
图表116 2015-2016财年高通公司收入分地区资料
图表117 2016年半导体企业排名
图表118 NXP主要业务
图表119 2015年新恩智浦半导体业务发展情况
图表120 汽车创新主要来自汽车电子
图表121 NXP提供完整的物联网解决方案
图表122 2015-2016财年博通有限公司综合收益表
图表123 2015-2016财年博通有限公司分部资料
图表124 2014-2015财年英伟达综合收益表
图表125 2014-2015财年英伟达分部资料
图表126 2014-2015财年英伟达收入分地区资料
图表127 2015-2016财年英伟达综合收益表
图表128 2015-2016财年英伟达分部资料
图表129 2015-2016财年英伟达收入分地区资料
图表130 2014-2015财年美国超微公司综合收益表
图表131 2014-2015财年美国超微公司分部资料
图表132 2014-2015财年美国超微公司收入分地区资料
图表133 2015-2016财年美国超微公司综合收益表
图表134 2015-2016财年美国超微公司分部资料
图表135 AMD未来两年的发展规划
图表136 2015-2016财年Marvell综合收益表
图表137 2015-2016财年Marvell分部资料
图表138 2015-2016财年Marvell收入分地区资料
图表139 2016-2017财年Marvell综合收益表
图表140 Marvell未来的主要业务方向
图表141 Marvell获得的市场领导地位
图表142 Marvell持续聚焦在中国的投入

图表143 Marvell从芯片层面上升到系统层面的创新
图表144 中国半导体未来发展机遇
图表145 Marvell中国主要业务布局
图表146 全球领先的无线连接方案提供商
图表147 完整的无线及IoT产品线
图表148 Marvell在IoT领域的产品线
图表149 全球领先的28nm WIFI/BT产品方案
图表150 Marvell广泛支持业界的协议及生态链
图表151 Marvell之恩对IoT应用的优化
图表152 Marvell CSI BU（Connection, Storage and Infrastructure）
图表153 Armada 3700面向丰富应用的领先SoC
图表154 Marvell家用NAS市场的需求
图表155 Marvell机遇Armada 3700的家用NAS方案示例
图表156 Marvell SSD市场趋势
图表157 2015-2016年Marvell主力控制器产品
图表158 Marvell给客户带来的独特优势
图表159 Marvell SEEDS运作模式
图表160 Marvell机遇Mochi的系SoC路线图
图表161 Andromeda BoxTM 平台
图表162 2015-2016财年Xilinx综合收益表
图表163 2015-2016财年Xilinx收入分地区资料
图表164 2016-2017财年Xilinx综合收益表
图表165 2014-2015财年Altera综合收益表
图表166 2014-2015财年英特尔综合收益表
图表167 2014-2015财年英特尔分部资料
图表168 2014-2015财年英特尔收入分地区资料
图表169 2015-2016财年英特尔综合收益表
图表170 2015-2016财年英特尔分部资料
图表171 2014-2015财年Cirrus Logic综合收益表
图表172 2014-2015财年Cirrus Logic分部资料
图表173 2014-2015财年Cirrus Logic收入分地区资料
图表174 2015-2016财年Cirrus Logic综合收益表
图表175 2015-2016财年Cirrus Logic分部资料
图表176 2014-2015年联发科技综合收益表
图表177 2015-2016年联发科技综合收益表

图表178 2014-2015年三星综合收益表
图表179 2014-2015年三星收入分地区资料
图表180 2015-2016年三星综合收益表
图表181 2015-2016年三星收入分地区资料
图表182 2013-2015年TowerJazz综合收益表
图表183 2015-2016年TowerJazz综合收益表
图表184 富士通三大业务部门
图表185 2014-2015财年富士通综合收益表
图表186 2015-2016财年富士通综合收益表
图表187 富士通下一代半导体芯片优势
图表188 2014-2015年台积电综合收益表
图表189 2014-2015年台积电分部资料
图表190 2014-2015年台积电分产品资料
图表191 2014-2015年台积电收入分地区资料
图表192 2015-2016年台积电综合收益表
图表193 2015-2016年台积电分部资料
图表194 台积电先进制造布局
图表195 2015年纯代工晶圆制造销售规模
图表196 2015-2016年全球先进纯代工晶圆制造市场规模增长情况
图表197 2014-2015年联华电子综合收益表
图表198 2015-2016年联华电子综合收益表
图表199 2014-2015年联电各制程节点营收比重
图表200 2014-2015年力晶科技综合收益表
图表201 2014-2015年力晶科技分产品资料
图表202 2014-2015年力晶科技收入分地区资料
图表203 2015-2016年力晶科技综合收益表
图表204 力晶未来研究计划及经费投入
图表205 2013-2015年中芯国际综合收益表
图表206 2013-2015年中芯国际分部资料
图表207 2013-2015年中芯国际收入分地区资料
图表208 2015-2016年中芯国际综合收益表
图表209 2015-2016年中芯国际收入分地区资料
图表210 2014-2015年华虹半导体综合收益表
图表211 2014-2015年华虹半导体收入分业务资料
图表212 2014-2015年华虹半导体收入分地区资料

图表213 2015-2016年华虹半导体综合收益表
图表214 2015-2016年华虹半导体收入分地区资料
图表215 集成电路封装
图表216 双列直插式封装
图表217 插针网格阵列封装（左）和无引线芯片载体封装（右）
图表218 鸥翼型封装（左）和J-引脚封装（右）
图表219 球栅阵列封装
图表220 倒装芯片球栅阵列封装
图表221 系统级封装和多芯片模组封装
图表222 2015全球前五大封测厂市场占有率
图表223 IC测试基本原理模型
图表224 2013-2015年艾克尔国际科技综合收益表
图表225 2013-2015年艾克尔国际科技分部资料
图表226 2013-2015年艾克尔国际科技收入分地区资料
图表227 2015-2016年艾克尔国际科技综合收益表
图表228 2014-2015年日月光综合收益表
图表229 2014-2015年日月光分部资料
图表230 2014-2015年日月光收入分地区资料
图表231 2015-2016年日月光综合收益表
图表232 2015-2016年日月光综合收益表半导体封装测试部分
图表233 2014-2015年矽品综合收益表
图表234 2014-2015年矽品分部资料
图表235 2014-2015年矽品收入分地区资料
图表236 2015-2016年矽品综合收益表
图表237 日矽合组控股公司的影响
图表238 日矽合组产业控股公司情况
图表239 2014-2015年南茂科技综合收益表
图表240 2014-2015年南茂科技分部资料
图表241 2014-2015年南茂科技收入分地区资料
图表242 2015-2016年南茂科技综合收益表
图表243 2015-2016年南茂科技分部资料
图表244 2015-2016年颀邦月合并营收表现
图表245 2014-2016年江苏长电科技股份有限公司总资产和净资产
图表246 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司营业收入和净利润
图表247 2016年江苏长电科技股份有限公司营业收入和净利润

图表248 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司现金流量
图表249 2016年江苏长电科技股份有限公司现金流量
图表250 2015年江苏长电科技股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区
图表251 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司成长能力
图表252 2016年江苏长电科技股份有限公司成长能力
图表253 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司短期偿债能力
图表254 2016年江苏长电科技股份有限公司短期偿债能力
图表255 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司长期偿债能力
图表256 2016年江苏长电科技股份有限公司长期偿债能力
图表257 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司运营能力
图表258 2016年江苏长电科技股份有限公司运营能力
图表259 2014-2015年江苏长电科技股份有限公司盈利能力
图表260 2016年江苏长电科技股份有限公司盈利能力
图表261 2014-2016年天水华天科技股份有限公司总资产和净资产
图表262 2014-2015年天水华天科技股份有限公司营业收入和净利润
图表263 2016年天水华天科技股份有限公司营业收入和净利润
图表264 2014-2015年天水华天科技股份有限公司现金流量
图表265 2016年天水华天科技股份有限公司现金流量
图表266 2015年天水华天科技股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区
图表267 2014-2015年天水华天科技股份有限公司成长能力
图表268 2016年天水华天科技股份有限公司成长能力
图表269 2014-2015年天水华天科技股份有限公司短期偿债能力
图表270 2016年天水华天科技股份有限公司短期偿债能力
图表271 2014-2015年天水华天科技股份有限公司长期偿债能力
图表272 2016年天水华天科技股份有限公司长期偿债能力
图表273 2014-2015年天水华天科技股份有限公司运营能力
图表274 2016年天水华天科技股份有限公司运营能力
图表275 2014-2015年天水华天科技股份有限公司盈利能力
图表276 2016年天水华天科技股份有限公司盈利能力
图表277 2016年通富微电收购情况
图表278 2014-2016年南通富士通微电子股份有限公司总资产和净资产
图表279 2014-2015年南通富士通微电子股份有限公司营业收入和净利润
图表280 2016年南通富士通微电子股份有限公司营业收入和净利润
图表281 2014-2015年南通富士通微电子股份有限公司现金流量
图表282 2016年南通富士通微电子股份有限公司现金流量

图表283 2015年南通富士通微电子股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区
图表284 2014-2015年南通富士通微电子股份有限公司成长能力
图表285 2016年南通富士通微电子股份有限公司成长能力
图表286 2014-2015年南通富士通微电子股份有限公司短期偿债能力
图表287 2016年南通富士通微电子股份有限公司短期偿债能力
图表288 2014-2015年南通富士通微电子股份有限公司长期偿债能力
图表289 2016年南通富士通微电子股份有限公司长期偿债能力
图表290 2014-2015年南通富士通微电子股份有限公司运营能力
图表291 2016年南通富士通微电子股份有限公司运营能力
图表292 2014-2015年南通富士通微电子股份有限公司盈利能力
图表293 2016年南通富士通微电子股份有限公司盈利能力
图表294 2014-2016年杭州士兰微电子股份有限公司总资产和净资产
图表295 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司营业收入和净利润
图表296 2016年杭州士兰微电子股份有限公司营业收入和净利润
图表297 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司现金流量
图表298 2016年杭州士兰微电子股份有限公司现金流量
图表299 2015年杭州士兰微电子股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区
图表300 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司成长能力
图表301 2016年杭州士兰微电子股份有限公司成长能力
图表302 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司短期偿债能力
图表303 2016年杭州士兰微电子股份有限公司短期偿债能力
图表304 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司长期偿债能力
图表305 2016年杭州士兰微电子股份有限公司长期偿债能力
图表306 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司运营能力
图表307 2016年杭州士兰微电子股份有限公司运营能力
图表308 2014-2015年杭州士兰微电子股份有限公司盈利能力
图表309 2016年杭州士兰微电子股份有限公司盈利能力
图表310 2009-2015年LED芯片供需情况分析
图表311 2013-2015年中国LED行业总产值情况
图表312 2011-2015年中国LED外延芯片行业产值情况
图表313 2011-2016年三安光电营收及净利润
图表314 2011-2015年同方股份营收及净利润
图表315 2011-2015年德豪润达营收及净利润
图表316 纯金线、高金线、合金线之相关特性比较表
图表317 半导体是物联网的核心

图表318 物联网领域涉及的半导体技术
图表319 2014-2016年物联网wifi芯片出货量
图表320 物联网wifi芯片原厂及方案商
图表321 全球民用无人机细分市场销量情况
图表322 2014年全球无人机市场分布格局
图表323 2015年全球军用无人机企业竞争格局
图表324 2015年全球民用无人机企业竞争格局
图表325 主要北斗应用的尺寸及价格敏感性分析
图表326 “北斗二号”导航芯片市场格局
图表327 2014-2015年500元以下可穿戴设备占比
图表328 2010-2015年全球及中国智能手机基带芯片出货量
图表329 2010-2015年中国智能手机基带芯片出货量在全球的占比
图表330 2010-2015年手机芯片厂商基带芯片出货量
图表331 2013-2015年中国市场4G芯片发展
图表332 2013-2015年中国市场智能手机多核发展趋势
图表333 2013-2015年中国品牌手机芯片核数发展
图表334 2014-2015年中国市场全模手机价位分布
图表335 2010-2015年全球及中国智能手机基带芯片出货量
图表336 2016年手机芯片性能排名
图表337 2016年手机芯片GPU性能排名
图表338 2016年手机芯片CPU单核性能排名
图表339 2016年手机芯片CPU综合性能排名
图表340 2009-2016年中国汽车电子市场规模及其增长率
图表341 各车型中汽车电子成本占比
图表342 汽车电子厂商竞争态势矩阵（CPM）分析
图表343 中国汽车电子厂商竞争力评价
图表344 汽车电子占汽车总成本的比例
图表345 2014-2015全球汽车半导体厂商收入排名top10
图表346 中投顾问对2016-2020年全球汽车电子市场规模预测
图表347 《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标
图表348 集成电路产业投资基金海外并购案例
图表349 2015年按照下游领域区分的集成电路产业销售额占比情况
图表350 2015-2016年集成电力主要应用领域的需求分析
图表351 2004-2015年全球及中国集成电路市场规模及占比
图表352 2004-2015年全球及中国集成电路市场规模

图表353 2004-2015年全球及中国集成电路产业销售额及占比
图表354 2005-2015年全球及中国集成电路产业销售额及增速
图表355 2004-2015年中国集成电路规模及销售额全球占比
图表356 22007-2016年中国集成电路进出口平均价格及溢价比例
图表357 2007-2020年中国集成电路设计业、制造业、封装测试业销售额占比情况
图表358 2010-2020年中国集成电路设计业、制造业、封装测试业销售额增速情况
图表359 2011-2015年全球集成电路产业销售额
图表360 2011-2015年全球半导体市场销售额
图表361 2011-2015年中国集成电路产业销售额
图表362 2011-2015年中国集成电路进出口额
图表363 2006-2015年全球及中国集成电路增速
图表364 2010-2019年中国本土芯片供需对比
图表365 2014年中国集成电路三业情况
图表366 2015年中国集成电路三业情况
图表367 2011-2015年中国半导体贸易逆差情况
图表368 2013-2016年世界半导体市场的统计和预测
图表369 2014年全球前20名半导体厂商收入排名预测
图表370 2010-2014年中国集成电路产业销售收入规模及增长
图表371 2015-2017年中国集成电路产业规模预测
图表372 2015-2017年中国集成电路产业各产业链销售收入
图表373 2014年中国集成电路产业各价值链结构
图表374 2015-2017年中国集成电路产业各产业链结构预测
图表375 2015-2017年中国半导体市场需求
图表376 2012-2016年全球半导体设备销售收入
图表377 2012-2016年中国半导体设备销售占比
图表378 2007-2017年中国IC制造产值占全球总产值份额
图表379 2015年中国集成电路产量
图表380 2015年中国集成电路产量统计表
图表381 2014年半导体设备厂商销售占比
图表382 2015年全球IC行业重大并购情况
图表383 2015年中国IC行业重大并购情况
图表384 2004-2015年全球及中国集成电路销售额趋势
图表385 2014-2017年全球集成电路投资规模及增长趋势
图表386 2014年至今大陆半导体投资额
图表387 2014年至今大陆芯片封装测试行业投资额

图表388 2014年至今大陆SOC数字芯片行业投资额
图表389 2014年至今大陆模拟芯片行业投资额
图表390 2014年至今大陆芯片生产设备行业投资额
图表391 无晶圆厂IC公司与IDM公司业绩总和比较
图表392 无晶圆厂IC公司与IDM公司业绩增长比较
图表393 中国大陆主要晶圆制造厂分布
图表394 IC业各大厂商大陆建厂计划
图表395 中国IC产业各环节占全球比重
图表396 2004-2014年中国IC产业销售收入结构示意图
图表397 IC行业产业链示意图

详细请访问：https://www.chyxx.com/research/201611/470591.html